

证券代码： 002449

证券简称：国星光电

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260630

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	奇瑞瑞丞基金、鲲鹏资本、华西证券、国泰海通证券、凯鼎资本、达瑞电子、信业集团、财信证券、珞瑜私募、熙宁投资、路翔投资、世传国际资本、泰禾私募、宽行私募、粤佛私募及 20 余位个人投资者
时间	2026 年 6 月 30 日（星期二）14:00-17:00
地点	佛山市禅城区华宝南路 18 号一楼大会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书李文强 2、研究院赵龙博士 3、董事会办公室（战略投资部）耿睿志
交流内容及具体问答记录	<p>1、2026 年度，公司在新业务拓展、大客户开拓等方面取得哪些进展？公司业务增量有哪些？</p> <p>公司回复：</p> <p>新业务拓展及大客户开拓进展方面：智能中控Mini LED背光通过了车规认证，实现了批量量产，与多家头部背光企业达成了合作。公司已进入主流消费电子及国际知名通信设备品牌供应链并批量供货；在车载LED领域，公司数字化大灯解决方案、交互屏方案让光成为人车路的对话语言，目前已获国内头部车企定点量产。</p> <p>业务增量方面：一是高清显示、智能显控业务快速成长。公司凭借深厚的RGB封装核心技术与软硬件结合一体化研发实力，依托长期深耕智能家居领域积累的客户资源，紧扣头部品牌智能化升级需求，联合研发点阵屏智能显控模组，打造新一代家电交互显示方案，产品集成蓝牙、语音、红外、Wi-Fi等多元互联功能，适配家电智能化、场景化发展需求，成为新的增长引擎；二是光电传感与光耦业务稳步上量。公司光耦产品已实现稳定量产，已进入工控、新能源</p>

电源等优质下游供应链，同时，公司VCSEL、车载视觉传感器产品持续迭代升级，在消费电子、车载智能应用领域持续放量，市场份额稳步提升。

2、公司光耦业务整体发展策略是什么？目前在新品研发、技术性能、下游市场渗透方面取得了哪些阶段性成效？

公司回复：

近年来，公司通过扩充光耦业务规模，完善产品矩阵，现已全面覆盖晶体管、可控硅、高速光耦、继电器光耦等主流品类，产品体系日趋完善。其中，核心产品FOC-817XX、10xx系列通过CQC、VDE、UL产品认证，357、SOP4等实现规模化生产，产能与交付能力持续夯实；同时，公司持续推进新品研发突破，成功开发出超小型化3H7产品并通过客户认证，进一步丰富产品线，拓宽产品应用场景。

在核心技术性能方面，公司攻坚高端性能指标，自主研发的DIP6封装可控硅光耦产品实现5000Vrms超高隔离耐压，主流性能全面对标国际一线品牌，可实现Pin to Pin兼容替换进口产品。

在下游市场渗透方面，公司深度布局工业自动化、家电、通信、光伏储能、数据中心等五大核心场景，持续推进各领域客户导入工作，已成功进入多家知名厂商供应链体系，在相关各个领域的国产化替代推进速度显著加快，市场渗透率与行业影响力稳步提升。

3、当前第三代半导体、功率半导体器件及高端封测赛道，受益于AI数据中心、光伏储能、新能源汽车、工控等高景气下游，国产替代空间广阔。请问公司子公司风华芯电如何把握行业增量红利，在高附加值赛道实现持续放量、提升市场份额？

公司回复：

风华芯电作为公司半导体封测业务核心主体，2026年重点推进车规级功率器件产线扩产，成功切入超充设备商供应链体系。同时，同步搭建功率模块产线与第三代功率半导体应用实验室，持续优化功率模块工艺技术，并推进100V氮化镓倒装封装及高密度SiP合封，强化高端半导体封测业务的规模化交付能力与市场竞争力。

4、公司围绕Mini/Micro LED、车载LED、半导体封测等赛道持续发力，后续在产业链并购整合方面有何整体规划？是否储备了相关并购项目？

公司回复：

公司高度重视产业并购对公司发展的战略作用，后续产业并购整体规划主要聚焦光电传感、汽车电子、先进半导体封测、显控模组、光互连几大方向寻求并购标的，通过专业化、战略性的产业并购助力公司从单一封装厂商向光电子综合方案服务商转型，培育新的业绩增长点。

目前，公司已常态化开展优质产业标的梳理与对接工作，建立了较为完善的项目储备体系，持续与多家优质产业标的保持深入沟通交流，部分并购项目处于对接、论证阶段。后续若推进相关并购事项，公司将严格按照监管规定，及时履行信息披露义务，相关情况请以公司官方公告为准。

5、公司是否有与产业投资方进行合作？是否有参与股权投资？

公司早年作为LP投资 1000 万元参与北京光荣联盟半导体照明产业投资中心，该基金由国家半导体照明联盟发起，聚焦LED、显示、第三代半导体、光电材料产业链开展股权投资，基金存续期间落地多个行业优质项目，其中两家企业已实现IPO上市：一是锆威特（688693），科创板上市，主营SiC功率半导体器件，契合当前新能源车、储能高景气赛道；二是晶科电子，港股上市，主营Mini/Micro LED、车载光电光源。

除此之外，该基金还间接布局显示驱动芯片龙头集创北方（A股IPO申报）；同时直投一批细分赛道优质企业，包括柔性触控材料厂商华纳高科、LED光学胶企业康美特、红外传感厂商旭晟光电、智慧照明企业创一佳等。

当年参与该基金，主要是依托产业联盟平台，提前布局上下游优质光电标的，同步开展产业链资源协同、技术合作。

6、公司近年来折旧费用偏高的原因？后续计划采取哪些举措缓解折旧压力？

公司回复：

公司近年来折旧费用偏高，主要源于持续的固定资产投资及吉利产业园相关基建陆续转固，随着各期扩产项目相继完工并入固定资产核算，公司折旧计提基数持续增加，因此年度折旧摊销相应增加。

公司已出台多项举措缓解折旧压力：一是产能统筹集中布局。将生产产能向吉利产业园智能化车间集中，新厂房配套设备综合生

	<p>产效率提升 20%以上，有效摊薄单位折旧成本；二是优化产品结构布局。新产线优先布局Mini/Micro LED等高毛利产品，用高附加值收益覆盖固定资产折旧成本；三是精细化生产与投资管控。通过柔性排产提升设备综合稼动率，同时优化产品结构，从严把控低效、低回报新增资本性支出。</p> <p>随着吉利产业园产能逐步释放，单位产品分摊折旧成本将持续下降，折旧对公司利润端的影响将逐年减弱。</p> <p>7、Micro LED光互联作为算力时代核心赛道，请问公司是否具备切入该赛道的能力？</p> <p>公司回复：公司具备LED外延芯片、先进光电封装、第三代半导体封测完整垂直产业链体系，具备布局Micro LED光互连赛道的技术与产业基础。公司子公司国星半导体深耕LED外延、芯片制造十余年，产品对标行业主流芯片厂商，借此公司可自主配套LED外延片、Micro LED芯片阵列，前期已开展了Micro LED阵列与COMS集成工艺开发等技术预研与布局，具备切入该赛道的能力。公司子公司风华芯电拥有 20 余条自动化半导体封测产线，可提供TO、DFN、SiP系统级等多类封装方案，并拥有先进封装设计能力。</p> <p>后续公司会持续跟踪Micro LED光互联产业的发展趋势，积极对接上下游产业链资源，开展新型光电封装领域的合作。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>